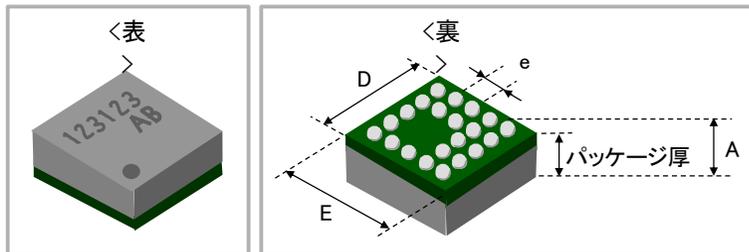


BGA/LGA Package lineup



パッケージ外形図 (BGAの例)

BGA/LGA パッケージラインナップ

パッケージ	パッケージ サイズ (mm)			e(端子間隔) (mm)	端子数									
	D(全長)	E(全幅)	A(全高)		8	9	17	54	81	88	140	163	225	
BGA	13.0	13.0	2.00	0.80									●	
	19.0	24.0	0.25	1.50								○		
LGA	9.0	9.0	1.29	0.50					○					
	11.0	15.0	1.00	1.10	○									
	14.0	22.6	1.00	0.80				●						
	19.3	28.0	1.10	0.80						○				
	21.9	29.4	1.18	2.50			○							
	21.9	14.0	1.18	2.50		○								
	27.0	29.0	1.60	0.80							○			

<パッケージ厚について>

・0.59~1.60mm typ. に対応可能 (基板があれば製作可能)

※ BGAについてはボールを除いた寸法

○ : 実績あり

● : 実績あり、生産あり